

南通富士通微电子股份有限公司 关于重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重大资产重组进展情况

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月15日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了重大资产购买预案等与本次重大资产重组相关的议案，并于2015年10月17日披露了重大资产购买预案及相关文件。

2015年10月23日，公司收到了深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对南通富士通微电子股份有限公司的重组问询函》[中小板重组问询函（不需行政许可）【2015】第 18号]，并于2015年10月29日披露了《南通富士通微电子股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）。公司股票自 2015年10月29日开市起复牌。

2015年12月25日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《南通富士通微电子股份有限公司与国家集成电路产业投资基金股份有限公司之共同投资协议》（以下简称“共同投资协议”）、《南通富士通微电子股份有限公司与国家集成电路产业投资基金股份有限公司之售股权协议》（以下简称“售股权协议”），并于2016年1月18日召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案，双方拟通过共同投资设立的公司分别收购超威半导体技术（中国）有限公司（“苏州目标公司”）及 Advanced Micro Devices Export Sdn. Bhd.（“槟城目标公司”）各85%的股权/股份。

截至本公告日，公司与 Advanced Micro Devices, Inc. 已签订《股权购买协议》，公司与国家集成电路产业投资基金股份有限公司签署了《共同投资协议》及《售股权协议》。本次重大资产重组事项涉及的标的资产的审计、估值等工作尚在进行中，独立财务顾问及其他机构正在开展重大资产购买报告书（草案）及相关文件的编制工作。

公司将在相关工作完成后及时召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，同时披露本次重大资产重组的相关文件。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知，并按照相关法律法规的规定，履行有关审批程序。

二、特别提示

1、截至本公告日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

2、请投资者仔细阅读公司《南通富士通微电子股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）》中披露的“重大风险提示”相关章节，风险提示内容包括：“审批风险”“国际化经营的风险”“商誉减值风险”“公司治理风险和整合风险”“法律、政策风险”“战略投资者合作不确定的风险”“业绩目标与安排尚未签署的风险”“客户集中度高的风险”“行业波动的风险”“标的资产的估值风险”“外汇风险”“股票投资风险”“其他风险”等。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司在发出召开审议本次重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重组工作进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会
2016年2月18日